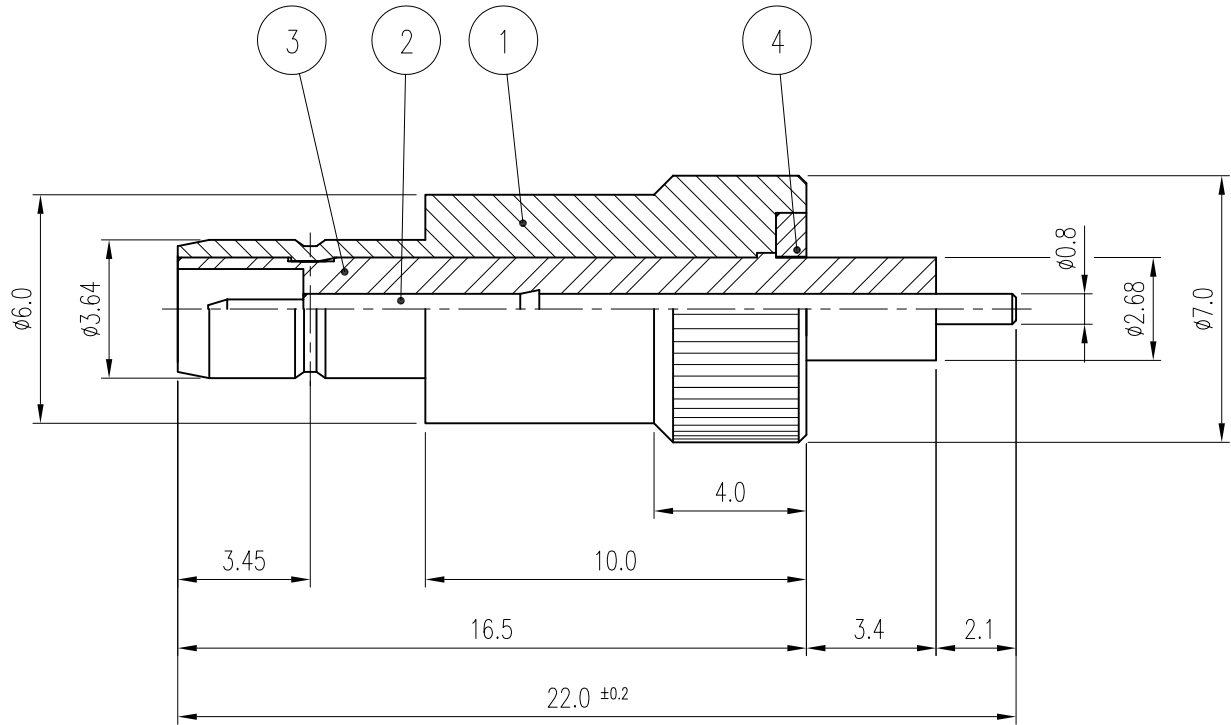


가 라 ST									수 정 내 용				
									부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)									A	도금 사양 변경	임채희	김준범	2004. 11. 15.
ST(개선)									B	신뢰성향상 (절면No. 연구2005-157) (TEFLON 밀링 방지 : 고정량 추가)	김은희	유일현	2005. 06. 14.
									OR	조립성향상 (절면No.20010-0005) (고정량.BODY 조립공차 변경)	강동우	최영호	2010. 01. 11.



OR	B	4	고정 RING	1	MBsBD	Gold Plate 0.4μ	L3019 (DSR00057-5/1)
		3	INSULATOR	1	TEFLON		H3131 (DIN00299-N/1)
	A	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate 0.4μ	E3149 (DCT00405-5/1)
OR	A	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate 0.4μ	D3150 (DBD00479-5/1)
대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고	

소재가능재질	품번		품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차	년월일 2010. 01. 11.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	소수	각도	분수				
	±0.1	±1°					
	재질				도명 SMB-J-RB		
	열처리						
보호피막처리				A4	도번 CN00895-7/1		
					K315-539-000		